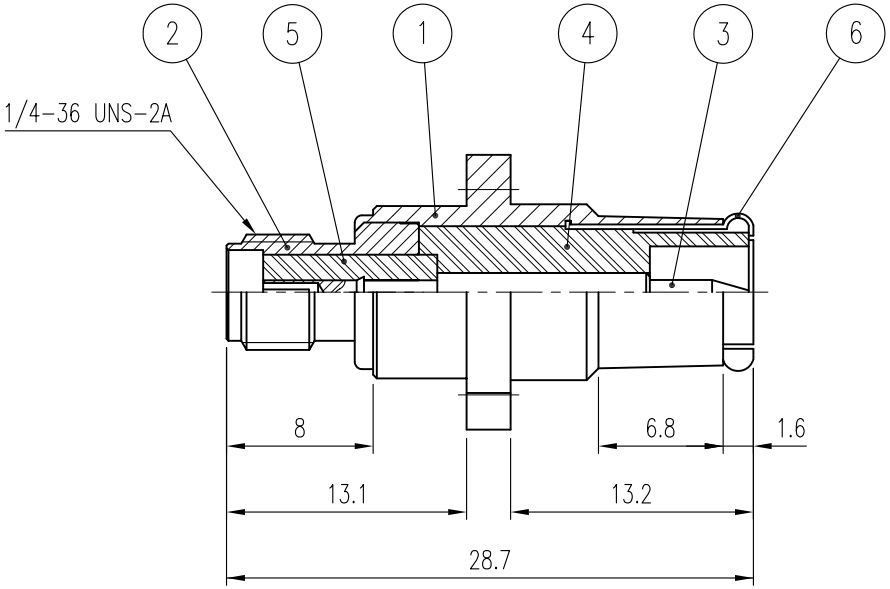
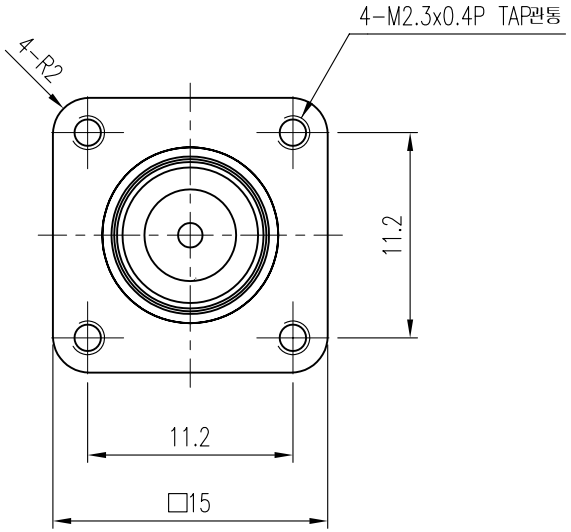
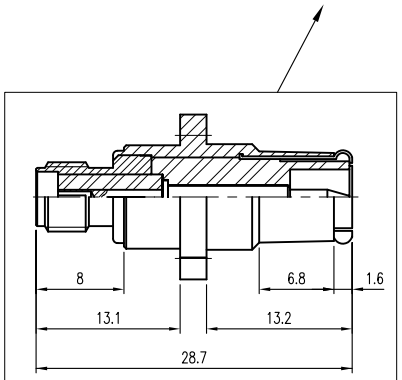
가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	원가절감 (설변No.연구2006-092) (PIN 형태 변경 및 절연체 변경 BODY 도금변경)	김인철	최충락	2006. 4. 11.
2	부적합 개선 (설변No.연구2006-116) (BODY내 절연체 삽입곤란 CODE 변경 HA015->HA219)	김인철	윤상진	2006. 5. 19.







1 설변전 VER.0

	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
	6	JACK	1	BeCu	Nickel Plate	J6001
2	5	INSULATOR	1	TEFLON		HA219 ~~HA015~~
1	4	INSULATOR	1	TEFLON		HA014
1	3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	EA013
	2	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DA184
1	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate ~~Nickel Plate~~	DA017

대체가능재질

공통공차 소수 각도 분수

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2001. 12. 20.

승인

검도

제도

직성부서 연 구 소

척도 2.5/1 단위 mm 중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMAJ-H4-TRUP VER.2

A4

도번 AD00163-7/1

K361-514-007